

(19)



(11) Veröffentlichungsnummer:

(11) Publication number:

EP 3 262 694 A0

(11) Numéro de publication:

Internationale Anmeldung veröffentlicht durch die
Weltorganisation für geistiges Eigentum unter der Nummer:

WO2017/066921 (Art. 153(3) EPÜ).

International application published by the World
Intellectual Property Organization under number:

WO2017/066921 (Art. 153(3) EPC).

Demande internationale publiée par l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous le numéro:

WO2017/066921 (art. 153(3) CBE).

专利名称(译)	微型led的转移方法，制造方法，装置和电子设备		
公开(公告)号	EP3262694A1	公开(公告)日	2018-01-03
申请号	EP2015906439	申请日	2015-10-20
[标]申请(专利权)人(译)	歌尔声学股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	歌尔声学. INC		
当前申请(专利权)人(译)	歌尔声学. INC		
[标]发明人	ZOU QUANBO WANG ZHE		
发明人	ZOU, QUANBO WANG, ZHE		
IPC分类号	H01L33/08 H01L33/00 H01L25/075		
CPC分类号	B32B37/025 H01L21/48 H01L24/75 H01L24/83 H01L24/97 H01L33/0093 H01L2224/7598 H01L2224/83 H01L2224/83005 H01L2224/97 H01L2924/12041 H01L21/6835 H01L22/20 H01L24/16 H01L24/81 H01L24/95 H01L25/0753 H01L2221/68322 H01L2221/68368 H01L2221/68381 H01L2224/131 H01L2224/16225 H01L2224/16238 H01L2224/81005 H01L2224/81024 H01L2224/81191 H01L2224/81815 H01L2224/8191 H01L2224/83851 H01L2224/95 H01L2224/95001 H01L2224/95136 H01L2224/81 H01L2924/00014 H01L2924/014 B81C3/001 H01L21/673 H01L21/67781		
其他公开文献	EP3262694B1 EP3262694A4		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明公开了一种微型LED的转移方法，制造方法，装置和电子设备。

在晶圆级转移微LED的方法包括：通过第一粘接层将激光透明原始基板上的微LED暂时粘接到载体基板上；用激光照射原始基板，剥离选定的微型LED；在第一粘合层上进行部分剥离，将所选择的微LED转移到载体基板上；通过第二粘合层将载体基板上的微LED暂时粘合到转移头基板上；在第一粘合层上执行完全释放，以将微LED转移到转移头基板；将转移头基板上的微LED接合到接收基板上；通过释放第二粘合层去除转移头基板，以将微LED转移到接收基板。